

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 7 年 6 月 25 日(2025.6.25)

【公開番号】特開 2023-99433(P2023-99433A)

【公開日】令和 5 年 7 月 13 日(2023.7.13)

【年通号数】公開公報(特許)2023-131

【出願番号】特願 2022-153760(P2022-153760)

【国際特許分類】

H 0 1 G 4/30(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 G 4/30 2 0 1 F

H 0 1 G 4/30 2 0 1 K

H 0 1 G 4/30 2 0 1 L

H 0 1 G 4/30 5 1 5

H 0 1 G 4/30 5 1 2

H 0 1 G 4/30 5 1 3

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 6 月 17 日(2025.6.17)

20

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 及び第 2 面、前記第 1 及び第 2 面と連結され、第 2 方向に対向する第 3 及び第 4 面、前記第 1 から第 4 面と連結され、第 3 方向に対向する第 5 及び第 6 面を含む本体と、

30

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、及び前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、及び前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部上に配置される第 1 絶縁層、及び前記第 2 接続部上に配置される第 2 絶縁層を含む絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層、及び前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層を含むめっき層と、を含み、

前記第 1 めっき層の一端部は、前記第 1 絶縁層の一端部と当接するように延び、前記第 2 めっき層の一端部は、前記第 2 絶縁層の一端部と当接するように延び、

40

前記第 1 めっき層の一端部と前記第 1 絶縁層の一端部が当接する領域、及び前記第 2 めっき層の一端部と前記第 2 絶縁層の一端部が当接する領域には段差が存在し、

前記めっき層の平均厚さは、前記絶縁層の平均厚さよりも薄い、積層型電子部品。

【請求項 2】

前記めっき層の平均厚さを t_1 、前記絶縁層の平均厚さを t_2 とするとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 3】

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、請求項 2 に記載の積層型電子部品。

【請求項 4】

50

前記めっき層の平均厚さは $0.5\ \mu\text{m}$ 以上 $15\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 5】

前記絶縁層の平均厚さは $1\ \mu\text{m}$ 以上 $20\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 6】

前記絶縁層はガラスを含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 7】

前記第 1 面から前記第 1 及び第 2 内部電極のうち、前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの第 1 方向の平均大きさを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端部までの第 1 方向の平均大きさを H_2 とするとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。 10

【請求項 8】

前記第 1 面から前記第 1 及び第 2 内部電極のうち、前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの第 1 方向の平均大きさを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端部までの第 1 方向の平均大きさを H_2 とするとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 9】

前記本体の第 1 方向の平均大きさを T とするとき、

前記 $H_2 < T/2$ を満たす、請求項 8 に記載の積層型電子部品。 20

【請求項 10】

前記第 1 及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 11】

前記本体の第 2 方向の平均大きさを L 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを B_2 とするとき、

$0.2 \leq B_1/L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2/L \leq 0.4$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 12】

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。 30

【請求項 13】

前記誘電体層の平均厚さは $0.35\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 14】

前記第 1 及び第 2 内部電極の平均厚さは、それぞれ $0.35\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 15】

前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、 40

前記カバー部の第 1 方向の平均大きさは $15\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 16】

前記第 1 めっき層は、前記第 1 絶縁層の前記第 1 面に近い端部を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記第 2 絶縁層の前記第 1 面に近い端部を覆うように配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 17】

前記第 1 絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端部を覆うように配置され、前記第 2 絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された 50

端部を覆うように配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 18】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 及び第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 及び第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 及び第 2 側面バンド部の第 2 方向の大きさは、前記第 1 面に近づくにつれて大きくなる、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 19】

前記第 1 及び第 2 外部電極は、前記第 5 及び第 6 面と離隔して配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。 10

【請求項 20】

前記第 1 及び第 2 外部電極は、前記第 2 面と離隔して配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 21】

前記第 1 及び第 2 絶縁層は、前記第 2 面に延びて互いに連結される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 22】

前記第 1 及び第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び第 6 面に延びて互いに連結される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。 20

【請求項 23】

前記絶縁層は、前記第 2、第 5、及び第 6 面に配置されない、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 24】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 25】

前記本体は、前記第 1 面と第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、 30

前記第 1 - 3 コーナー及び第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部において前記第 1 - 3 コーナー及び第 2 - 3 コーナー上に延びて配置される第 1 コーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 1 - 4 コーナー及び第 2 - 4 コーナー上に延びて配置される第 2 コーナー部を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 26】

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均大きさを B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均大きさを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均大きさを G 2 とするとき、 40

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、請求項 25 に記載の積層型電子部品。

【請求項 27】

前記第 1 外部電極は、前記第 3 面上に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 面上に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 4 面上に配置される第 2 連結電極、及び前記第 1 面上に配 50

置されて前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 28】

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置されて、前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置されて、前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、請求項 27 に記載の積層型電子部品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0278

10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0278】

本発明に用いられた用語は、単に一実施形態を説明するために用いられたものであり、本発明を限定することを意図するものではない。ここで、単数の表現には、文脈上明らかに他の意味を示さない限り、複数の表現を含む。

本明細書によれば、以下の各項目に記載の構成もまた開示される。

(項目 1)

誘電体層、並びに前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、並びに前記第 1 面から第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

20

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 2 面上に配置されて前記第 1 接続部及び第 2 接続部上の一部まで延びて配置される絶縁層と、

30

前記第 1 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 2 めっき層とを含み、

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さが前記絶縁層の平均厚さより薄い、積層型電子部品。

(項目 2)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さが前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 3)

40

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さを t_1 、前記絶縁層の平均厚さを t_2 としたとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 4)

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、項目 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 5)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1' とするとき、 t_1' / t_2 は 0.67 以下である、項目 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 6)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さはそれぞれ、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 に記載の積層型電子部品。

50

(項目7)

前記絶縁層の平均厚さは、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $20\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目8)

前記絶縁層は、ガラスを含む、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目9)

前記第1面から前記第1内部電極及び第2内部電極のうち前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズを H_1 、前記第1面の延長線から前記第1接続部及び第2接続部に配置された第1めっき層又は第2めっき層の端部までの前記第1方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、項目1に記載の積層型電子部品。

10

(項目10)

前記第1面から前記第1内部電極及び第2内部電極のうち前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズを H_1 、前記第1面の延長線から前記第1接続部及び第2接続部に配置された第1めっき層又は第2めっき層の端部までの前記第1方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目11)

前記本体の前記第1方向の平均サイズを T としたとき、

前記 H_2 及び前記 T は、 $H_2 < T/2$ を満たす、項目10に記載の積層型電子部品。

20

(項目12)

前記本体の前記第2方向の平均サイズを L 、前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_1 、前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$0.2 \leq B_1/L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2/L \leq 0.4$ を満たす、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目13)

前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目14)

30

前記第1外部電極及び第2外部電極は、 Ni 及び Ni 合金のうち1つ以上を含む、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目15)

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_1 、前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_2 、前記第3面の延長線から前記第3バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_3 、前記第4面の延長線から前記第4バンド部の端部までの前記第2方向の平均サイズを B_4 としたとき、

$B_3 < B_1$ 及び $B_4 < B_2$ を満たす、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目16)

40

前記第1接続部及び第2接続部は、前記第5面及び第6面から離隔して配置される、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目17)

前記積層型電子部品は、前記第2方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第3方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目18)

前記誘電体層の平均厚さは、 $0.35\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目1に記載の積層型電子部品。

(項目19)

前記第1内部電極及び第2内部電極の平均厚さは、 $0.35\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目1に

50

記載の積層型電子部品。

(項目 20)

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは、 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 21)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 22)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記絶縁層の端部の一部を覆うように配置される、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 23)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の端部の一部を覆うように配置される、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 24)

誘電体層、並びに前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、並びに前記第 1 面から第 4 面と連結されて第 3 方向

に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、及び前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、及び前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 2 面の全部を覆うように配置されて前記第 1 接続部及び第 2 接続部上の一部まで延びて配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 2 めっき層とを含み、

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さを t_1 、前記絶縁層の平均厚さを t_2 としたとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、積層型電子部品。

(項目 25)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1' とするとき、 t_1' / t_2 は 0.67 以下である、項目 24 に記載の積層型電子部品。

(項目 26)

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、項目 24 に記載の積層型電子部品。

(項目 27)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さ (t_1) は、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 24 に記載の積層型電子部品。

(項目 28)

前記絶縁層の平均厚さ (t_2) は、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $20\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 24 に記載の積層型電子部品。

(項目 29)

前記絶縁層は、ガラスを含む、項目 24 に記載の積層型電子部品。

(項目 30)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前記第

10

20

30

40

50

1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 1)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 2)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたとき、

前記 H_2 及び前記 T は、 $H_2 < T / 2$ を満たす、項目 3 1 に記載の積層型電子部品。

10

(項目 3 3)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 4)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 5)

20

前記第 1 外部電極及び第 2 外部電極は、 Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 6)

前記第 1 接続部及び第 2 接続部は、前記第 5 面及び第 6 面から離隔して配置される、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 7)

前記第 1 接続部及び第 2 接続部は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 8)

前記積層型電子部品は、前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

30

(項目 3 9)

前記誘電体層の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 0)

前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 1)

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

40

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは、 $15 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 2)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 3)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記絶縁層の端部の一部を覆うように配置される、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 4)

50

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の端部の一部を覆うように配置される、項目 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 5)

誘電体層、並びに前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、並びに前記第 1 面から第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、及び前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、及び前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部を含む第 2 外部電極と、 10

前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置されて前記絶縁層に接するように延びて配置される第 2 めっき層とを含み、

前記第 1 外部電極及び第 2 外部電極は、前記第 2 面の延長線以下に配置され、

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さを t_1 、前記絶縁層の平均厚さを t_2 としたとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、積層型電子部品。

(項目 4 6)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1' とするとき、 t_1' / t_2 は 0.67 以下である、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 7)

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 8)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さ (t_1) は、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 9)

前記絶縁層の平均厚さ (t_2) は、 $1 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 以下である、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 5 0)

前記絶縁層は、ガラスを含む、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 5 1)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 5 2)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、項目 4 5 に記載の積層型電子部品。 40

(項目 5 3)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたとき、

前記 H_2 及び前記 T は、 $H_2 < T / 2$ を満たす、項目 5 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 5 4)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド 50

部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 55)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 56)

前記第 1 外部電極及び第 2 外部電極は、Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 57)

前記第 1 接続部及び第 2 接続部は、前記第 5 面及び第 6 面から離隔して配置される、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 58)

前記第 1 接続部及び第 2 接続部は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 59)

前記積層型電子部品は、前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 60)

前記誘電体層の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 61)

前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 62)

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは、 $15 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 63)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 64)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記絶縁層の端部の一部を覆うように配置される、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 65)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の端部の一部を覆うように配置される、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 66)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 バンド部に配置される第 1 バンド電極を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部に配置される第 2 連結電極、及び前記第 2 バンド部に配置される第 2 バンド電極を含む、項目 45 に記載の積層型電子部品。

(項目 67)

誘電体層、並びに前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、並びに前記第 1 面から第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる

10

20

30

40

50

第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面と前記第 3 面とを連結するコーナーに延びて配置される第 1 コーナー部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面と前記第 4 面とを連結するコーナーに延びて配置される第 2 コーナー部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、並びに前記第 1 コーナー部及び第 2 コーナー部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層とを含み、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたとき、

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たし、

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さが前記絶縁層の平均厚さより薄い、積層型電子部品。

(項目 6 8)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さが前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 9)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1 、前記絶縁層の平均厚さを t_2 としたとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 0)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1' とするとき、 t_1' / t_2 は 0.67 以下である、項目 6 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 1)

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、項目 6 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 2)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さは、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 6 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 3)

前記絶縁層の平均厚さは、 $1 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 4)

前記絶縁層は、ガラスを含む、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 5)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 6)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 7)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたとき、

前記 H 2 及び前記 T は、 $H_2 < T / 2$ を満たす、項目 7 5 に記載の積層型電子部品。

10

20

30

40

50

(項目 7 8)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 7 9)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 0)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 1)

前記第 1 外部電極及び第 2 外部電極は、Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 2)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$B_3 < B_1$ 及び $B_4 < B_2$ を満たす、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 3)

前記積層型電子部品は、前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 4)

前記誘電体層の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 5)

前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極の平均厚さは、 $0.35 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 6)

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは、 $15 \text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 7)

前記第 1 コーナー部及び第 2 コーナー部は、前記第 2 面の延長線以下に配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 8)

前記第 1 接続部及び第 2 接続部は、前記第 5 面及び第 6 面から離隔して配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 9)

前記第 1 コーナー部及び第 2 コーナー部は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 0)

前記第 1 めっき層は、前記第 1 外部電極上に配置された前記絶縁層の端部を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記第 2 外部電極上に配置された前記絶縁層の端部を覆うように配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 1)

前記絶縁層は、前記第 1 外部電極上に配置された前記第 1 めっき層の端部を覆うように

10

20

30

40

50

配置され、前記絶縁層は、前記第 2 外部電極上に配置された前記第 2 めっき層の端部を覆うように配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 2)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 3)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端部までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたとき、

$B_1 \leq G_1$ 及び $B_2 \leq G_2$ を満たす、項目 6 7 に記載の積層型電子部品。

10

(項目 9 4)

誘電体層、並びに前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、並びに前記第 1 面から第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を含む本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 面に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 連結電極、及び前記第 1 面に配置されて前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 連結電極上に配置される第 1 絶縁層と、

20

前記第 2 連結電極上に配置される第 2 絶縁層と、

前記第 1 バンド電極上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド電極上に配置される第 2 めっき層とを含み、

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さが前記第 1 絶縁層又は第 2 絶縁層の平均厚さより薄い、積層型電子部品。

(項目 9 5)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さは、前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層の平均厚さより小さい、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 6)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さを t_1 、前記第 1 絶縁層又は第 2 絶縁層の平均厚さを t_2 としたとき、 t_1 / t_2 は 0.67 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

30

(項目 9 7)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層の平均厚さを t_1' 、前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層の平均厚さを t_2' とするとき、 t_1' / t_2' は 0.67 以下である、項目 9 6 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 8)

前記 t_1 / t_2 は 0.5 以下である、項目 9 6 に記載の積層型電子部品。

(項目 9 9)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さは、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

40

(項目 100)

前記第 1 絶縁層又は第 2 絶縁層の平均厚さは、 $1 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 101)

前記第 1 絶縁層又は第 2 絶縁層は、ガラスを含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 102)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び第 2 連結電極上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前

50

記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 > H_2$ を満たす、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 3)

前記第 1 面から前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び第 2 連結電極上に配置された第 1 めっき層又は第 2 めっき層の端部までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたとき、 $H_1 < H_2$ を満たす、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 4)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたとき、

10

前記 H_2 及び前記 T は、 $H_2 < T / 2$ を満たす、項目 1 0 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 5)

前記第 1 めっき層及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 6)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド電極と前記第 2 バンド電極間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 7)

前記第 1 連結電極及び第 2 連結電極は、 Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

20

(項目 1 0 8)

前記積層型電子部品は、前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 0 9)

前記誘電体層の平均厚さは、 $0.35\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 0)

前記第 1 内部電極及び第 2 内部電極の平均厚さは、 $0.35\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 1)

30

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズは、 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 2)

前記第 1 めっき層又は第 2 めっき層の平均厚さは、前記第 1 絶縁層又は第 2 絶縁層の平均厚さより薄い、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 3)

前記第 1 連結電極及び第 2 連結電極は、前記第 5 面及び第 6 面から離隔して配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

40

(項目 1 1 4)

前記第 1 連結電極及び第 2 連結電極は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 5)

前記第 1 めっき層は、前記第 1 外部電極上に配置された前記第 1 絶縁層の端部を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記第 2 外部電極上に配置された前記第 2 絶縁層の端部を覆うように配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 6)

前記第 1 絶縁層は、前記第 1 外部電極上に配置された前記第 1 めっき層の端部を覆うよ

50

うに配置され、前記第 2 絶縁層は、前記第 2 外部電極上に配置された前記第 2 めっき層の端部を覆うように配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 7)

前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び第 6 面に延びて互いに連結され、前記第 5 面及び第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 8)

前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び第 6 面に延びて互いに連結され、前記第 5 面及び第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 1 9)

前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層は、前記第 2 面に延びて互いに連結される、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。 10

(項目 1 2 0)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面とを連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と前記第 4 面とを連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と前記第 3 面とを連結する第 2 - 3 コーナー、及び前記第 2 面と前記第 4 面とを連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第 1 連結電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含み、前記第 2 連結電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含む、項目 1 1 6 に記載の積層型電子部品。 20

(項目 1 2 1)

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置され、前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置され、前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 2)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端部までの距離を B 1、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド電極の端部までの距離を B 2、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端部までの距離を B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端部までの距離を B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたとき、 30

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2 及び B 4 G 2 を満たす、項目 1 2 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 3)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端部までの距離を B 1、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド電極の端部までの距離を B 2、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端部までの距離を B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端部までの距離を B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極とが離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたとき、 40

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2 及び B 4 G 2 を満たす、項目 1 2 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 4)

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、前記第 1 内部電極又は第 2 内部電極に含まれる金属と同じ金属を含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 5)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記第 1 内部電極又は第 2 内部電極に含ま 50

れる金属と同じ金属を含む、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 6)

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成 (f i r i n g) 電極である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 7)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成 (f i r i n g) 電極である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 8)

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、めっき層である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 9)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、めっき層である、項目 9 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 0)

前記同じ金属は、N i である、項目 1 2 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 1)

前記同じ金属は、N i である、項目 1 2 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 2)

前記導電性金属は、ニッケル (N i) 、銅 (C u) 及びこれらの合金のうち 1 つ以上である、項目 1 2 6 に記載の積層型電子部品。

10

20

30

40

50